

0000073-044441

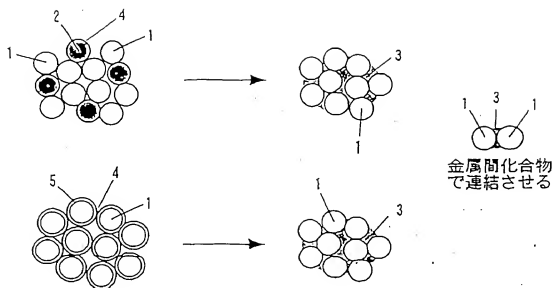
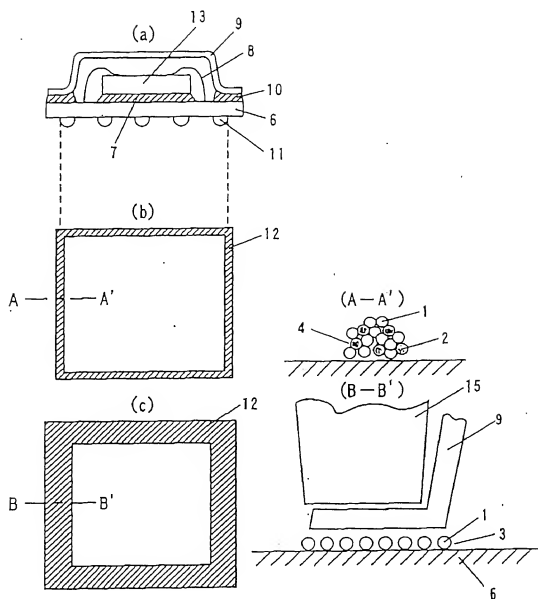


図1

00000731-00000000



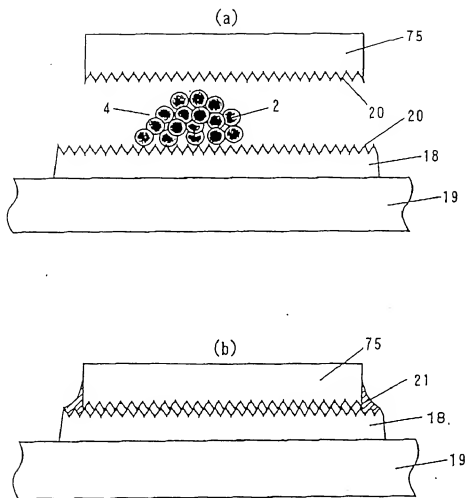


图 3

0000073 061004
100190 0020000

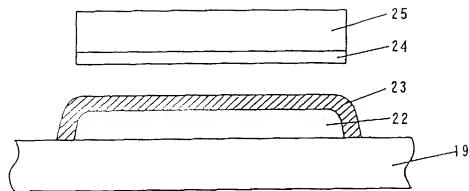
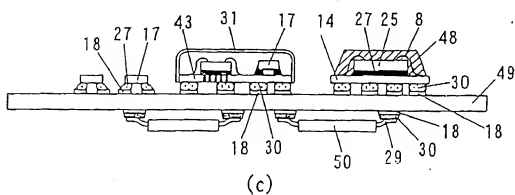
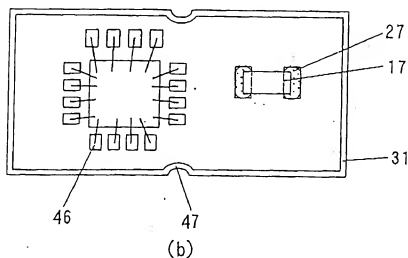
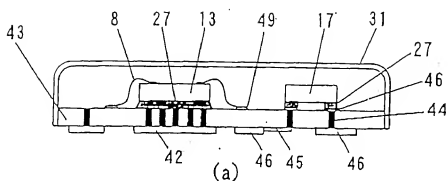


图4

(c)

図6

100195-220880



多層セラミック基板準備

Cu, Snはんだペースト塗布

ダイボンド下デイスペンサー塗布

部品搭載

ダイボンド(平坦化)

リフロー

洗浄

ワイヤボンド

樹脂印刷塗布

樹脂硬化

マーク

基板分割

電気的特性チェック

モジュール完成

(a)モジュール組立工程

プリント基板準備

はんだペースト塗布

モジュール搭載

リフロー

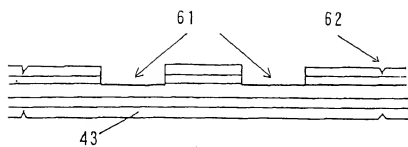
電気的特性チェック

実装完成

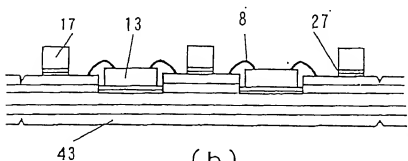
(b)モジュール2次実装組立工程

図 8

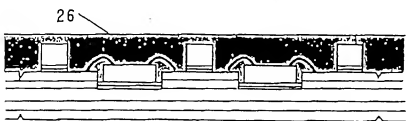
00000733-001001



(a)



(b)



(c)

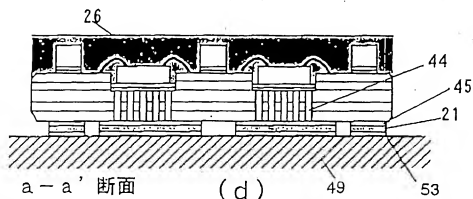


图 9

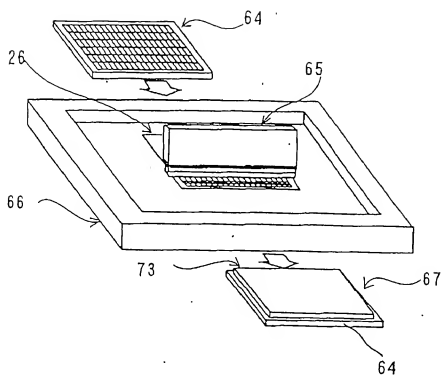


FIG. 10

09860733-001301

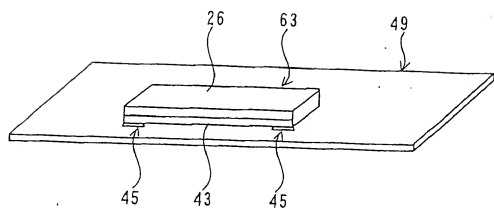
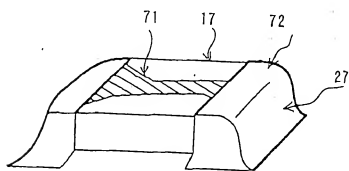


图 11

(a)



(b)

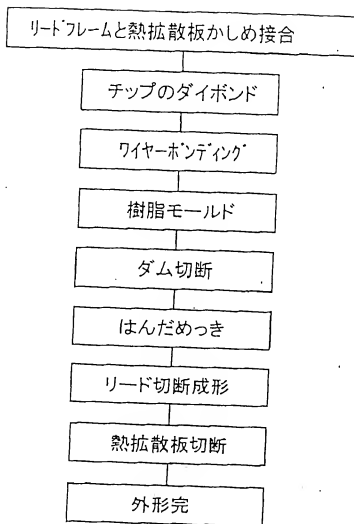


図15

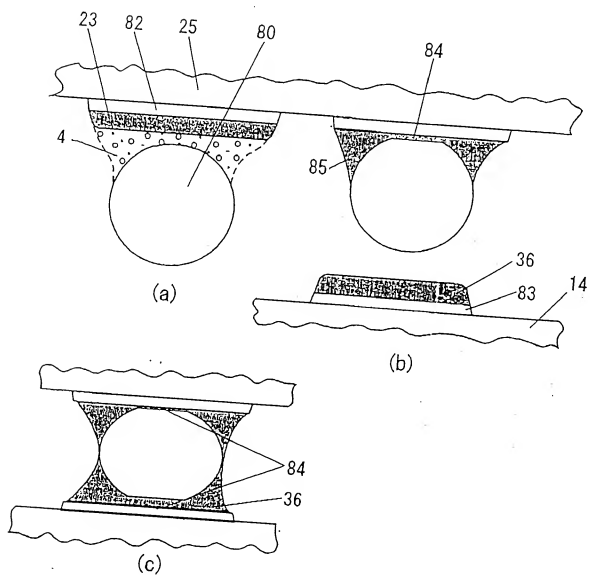
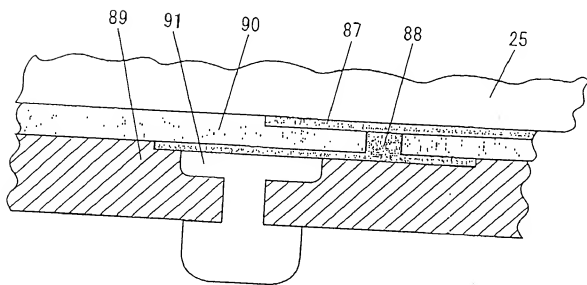
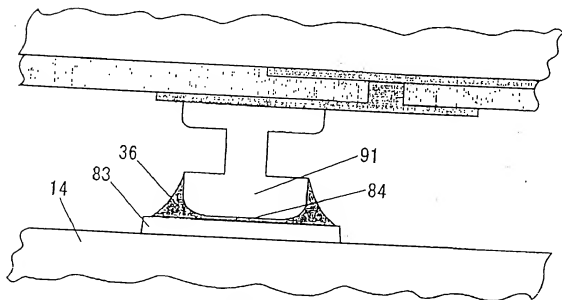


图17

0386073.001700



(a)



(b)

[illegible]

判定基準：○：適正、
△：ほぼ適正
×：Sn不足(過多)

图 19